

The Next Generation Ionizer

New Soft X-ray Ionizer



SXN-05/10N

먼지, 전자파, 오존 발생이 전무해 고 청정지역 공정에 적합한 차세대 정전기 제거장치입니다. 면발광 LED를 적용해 원거리 및 다양한 각도에서 제품의 동작 상태를 확인 할 수 있으며, Head 위치와 Serial Number를 Controller 에서 확인 가능합니다. 기존 제품 대비 다양한 사용자 편의성을 향상시킨 제품입니다.

Key Features

- 면발광 LED를 적용해 다양한 각도에서 동작 상태 확인 가능
- Head의 Serial Number를 Controller에서 확인 가능
- Head 위치 확인 가능
(Controller에서 Head를 선택하면 해당 Head LED가 6초간 점멸)
- Head와 Controller의 통신 상태가 비 정상일 경우 자동 정지
- RS-485 통신 프로토콜을 이용해 Head 4대의 개별 On/Off 제어 가능
- 기본값(9600 bps) 외 3가지 통신 속도 설정 지원
(9600, 19200, 38400, 56000 bps)
- 원자력 안전법 시행령 제 8조에 의거, 별도의 신고 의무 면제(SXH-05N)



Specifications

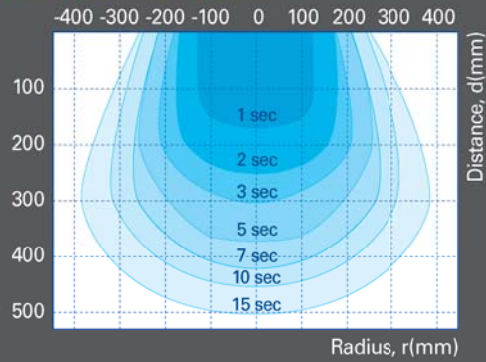
Parameter		Description / Value
Ion Generation Method		Soft X-ray
Source		Soft X-ray Tube
Beam Angle		150°
Input Power		AC 100~240V, 50/60Hz
Power Consumption (with Head)		Max. 50W
Controller Fuse		250V, 3A, 5X20 Glass Type Fuse
Operation Circumstance		0°C ~ +50°C(32°F ~ 122°F), 35% ~ 85% RH
Weight	Head (SXH-05/10N)	0.27kg
	Controller (SXC-104N)	0.62kg
Dimensions		Please Refer to Dimension Drawing
Alarm Function		Head Fail, Head Communication Error
Interface		(Run, Alarm, Power, Over Time, Remote, Interlock) Remote On/Off, Interlock On/Off, Output State
Warranty		1 year

※ 디자인 및 제품 사양은 품질향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

Performance

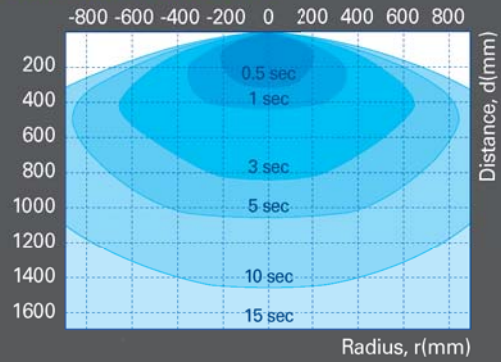
▶ SXN-05N

Radiation Angle ≙ 150°



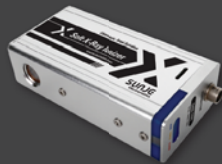
▶ SXN-10N

Radiation Angle ≙ 150°



LED 컬러별 동작 상태

Blue : Run



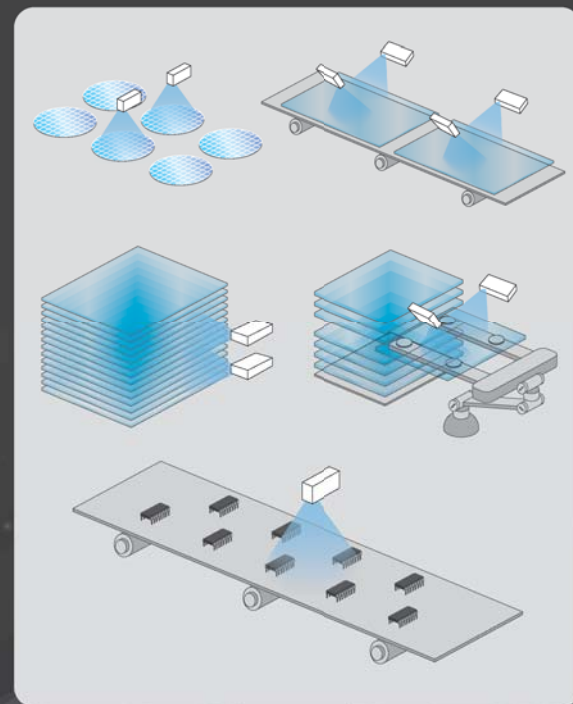
Yellow : Overtime



Red : Alarm

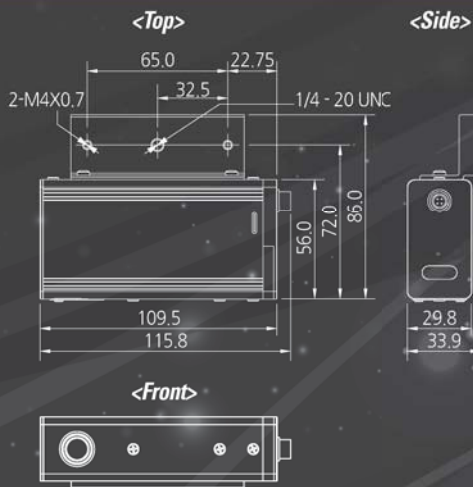


Applications



Semiconductor Die-Bonding / Wire Bonding / Chip Molding / Trimming & Forming Testing / Polarizer Separating / Glass Cassette / Wafer Cassette / Film Attachment / Exposure / Wafer Oxidation / Etching / Ion Implant / Glass & Wafer Dry / PI Coating / Rubbing / PR Coating / Curing & Baking / Glass Assembly / ODF / Glass & Wafer Cassette Buffer / Conveyor Robot / etc.

Dimensions



※ Soft X-Ray Ionizer란?

연X선의 공기전리작용을 사용한 정전기 제거장치로서 먼지, 전자파, 오존발생이 없고 압축공기 등이 불필요하며, 별도의 유지보수가 필요없는 차세대 정전기 제거장치입니다.